「SEMICON Japan 2026」ブース装飾等委託業務
仕様書

1　SEMICON Japan 2026　概要及びブース出展概要

（1） SEMICON Japan 2026

開催期間：令和8年12月9日（水曜日）～11日（金曜日）

開催場所：東京ビッグサイト(東京都江東区有明３－１１－１)

主　　催：SEMI

（2）ブース出展概要

主　　催：福岡県半導体・デジタル産業振興会議

ブース数：合計８小間（72㎡）

（１小間：３ｍ×３ｍ＝９㎡）

2　委託業務内容

SEMICON Japan 2026へのブース展示に係る運営並びに装飾に係るデザイン、設営、施工及び撤去等の一切の業務（ブース内の電気・設備等を含む）

（1）運営全般

・ブース展示に係る出展企業との事前の連絡調整や設営及び会期中の各種対応などの運営業務を行うこと。

（2）装飾全般

・福岡県のブースとして認識しやすく、かつ「集客」が期待できるデザインとすること。

・ブース内に「出展者ブース」「総合案内」「商談スペース」及び最低限の「ストックヤード」を設けること。

・「商談スペース」は、ブース外から見える位置に配置し、２か所設けること。

・当展示会の装飾規程を熟読の上、装飾案を作成すること。
装飾規程が必要な場合は、福岡県半導体デジタル産業振興課議事務局までご連絡ください。
（電話：０９２－６４３－３４４５　E-mail：info@robot-system.jp）

（3）展示ブース

・インフォメーションブースを１ブース、出展者ブースを11ブース設営すること。

・出展者ブースは１ブース当たり幅2.0m程度×奥行1.0m程度のスペースを確保すること。

・各ブースの基本設備は以下のとおりとし、その他、集客や機能性の向上に資する設備等があれば提案すること。

【各ブースの基本設備】

① 社名板 ×　１枚

② 展示台（幅１．５m程度×奥行０．５m程度×高さ１m程度）
※寸法は参考程度とし、レイアウト等による若干の増減は問題ない。

③ コンセント　１００Ｖ（２口）

④ 展示用パネル×　１～２枚

（4）その他

・出展に当たり、集客効果を高める独自アイデアがあれば、積極的に提案すること。

3　実績報告等

令和9年1月29日(金曜日)までに振興会議に次の書類を提出すること。

・委託業務完了報告書

・事業実績報告書

※上記書類は、電子ファイル（Word、Excel、PowerPointいずれかのファイル形式及びPDF形式）にて提出すること。

4　再委託について

本業務の実施において再委託を行う場合は、事業者の選定は公正に行い、あらかじめ振興会議の承認を得ること。

また、再委託事業者へ研修会等を実施し、進捗管理の徹底及び事業間連携を図ること。

5　実施に当たっての留意事項

（1）本事業の実施に当たっては、展示会主催者の定める出展規定を満たすこと。

（2）見積額には電気幹線工事費（1次側)、電気使用費も盛り込むこと。

（3）福岡県半導体・デジタル産業振興会議の代理として、展示会主催者に対し、装飾に関連する手続きを行うこと。

（4）事業の実施に当たっては、関係法令及び県の条例等を遵守すること。

（5）事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うこと。

（6）本事業に関し、出展企業の情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、事業の目的の達成に必要な範囲内で行うこと。

（7）振興会議が事業の運営上必要な措置を講ずるべき事案が発生したと判断した場合は、受託事業者は、振興会議の指示に基づき迅速かつ適切に対応しなければならない。

（8）レイアウトや出展企業の変更により、仕様に変更が生じた場合は、振興会議と受託事業者が協議し、決定するものとする。

（9）そのほか、本仕様書に定めのない事項については、振興会議と受託事業者が協議し、決定するものとする。